

## マニピュレーター環境下で思いのままにマイクロ切削 !!



いままでは難しくてあきらめていたような、樹脂などに埋没した異物の切削を短時間でどなたにでも行なえるように開発された、切削アタッチメントです。

弊社製マイクロマニピュレーター【アクシスプロ】に取り付けて使用することにより、 $2\mu\text{m}$ ～ $300\mu\text{m}$ 程度の深さに埋没している異物も、モニター上で視認した状態で切削することができます。

付属の専用切削ツールを対象物に応じて選択する事により、切削エリア、切削深さのコントロールが自在です。

### 《主な仕様》

- ・コントローラ:  $85\text{W} \times 290\text{D} \times 140\text{H}$  (3kg)
- ・ミリングユニット:  $\phi 28\text{mm} \times 140\text{L}$  (0.2kg)
- ・電源: AC100V 50/60HZ 定格消費電力: 25VA



### 《セット内容》

- ①コントローラ ②スタートストップボタン
- ③ミリングユニット ④安全カバー
- ⑤アクシスプロ取付アーム(角度可変・回転機構)
- ⑥専用ミリングツール4種類セット

※(MPE1-M)(MPE2-M)(CP-M)(TP-M)各1本※

### 《アプリケーション例》 ※一部※

- 樹脂材料に埋没した異物の掘り出し(顕微IR)、薄片化
- 埋没異物の平面切削(顕微ATR用頭出し)
- 一定深さでの広範囲の平面切削( $50\mu\text{m}$ □～)
- ガラス、ウェハ、金属試料へのマーキング(FIB加工用)
- 表面から深さ方向へのFTIR劣化度測定前処理
- ICパッケージ、液晶パネル封止材のピンポイント切削
- 内部欠陥へのコンタクト(X線顕微鏡、ICチップ劈開用野書き)

### 《切削可能材料》 ※主なもの※

#### ◆樹脂系◆

ポリカーボネート、ポリイミド、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリブチレン、メタクリレート、PET、フッ素樹脂、塗装膜、

#### ◆無機材料◆

鉄系金属、非鉄系金属、岩石、シリコンウェハ他

